



2007年3月期決算補足資料
2007年5月

東証1部・大証1部:6315

TOWA株式会社

Challenge 30

誇りあるTOWAブランド確立に向けて!

2007年3月期決算 会社説明会

2007年5月

TOWA株式会社

1

本日の説明内容

1. 2007年3月期実績
2. 2008年3月期計画
3. 中期経営計画進捗状況および今後の運営方針

2

1. 2007年3月期実績

3

2007年3月期実績概要(連結)

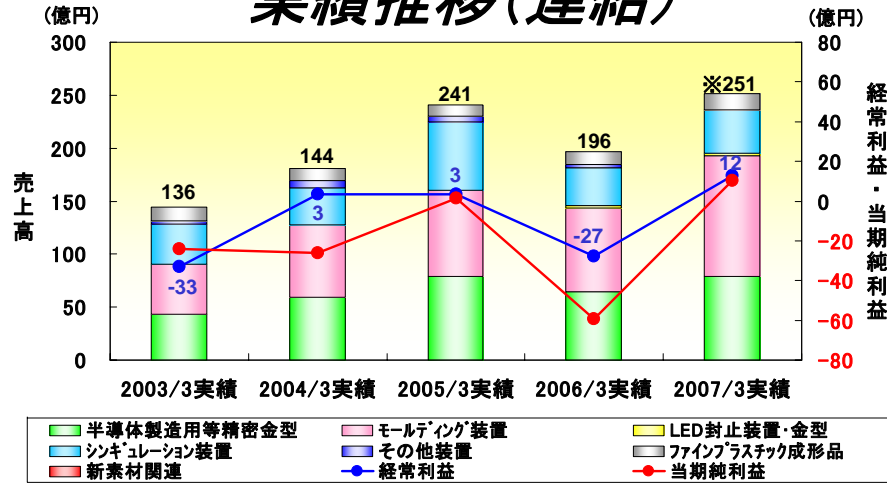
(百万円)

	連結		
	期初目標	実績	目標比
売上高	20,000	※25,159	+5,159
営業利益	420	1,224	+804
経常利益	250	1,289	+1,039
当期純利益	130	1,038	+908

※国内子会社2社の決算期変更に伴う売上高の増加6億円を含む

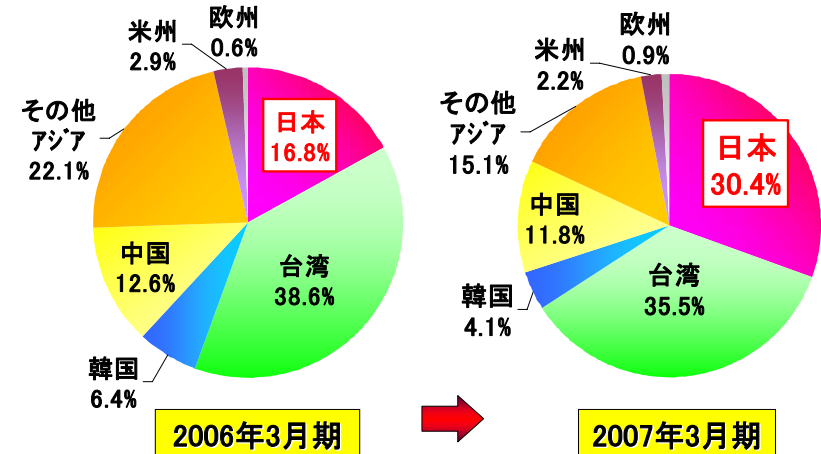
4

業績推移(連結)



※国内子会社2社の決算期変更に伴う売上高の増加6億円を含む

地域別売上高(連結)



2. 2008年3月期計画

2008年3月期計画(連結)

(百万円)

	2008年3月期 計画		2007年3月期 実績		増減額 (増減率)
	金額	構成比	金額	構成比	
売上高	26,000	100.0%	※25,159	100.0%	+841 (+3.3%)
営業利益	1,900	7.3%	1,224	4.9%	+676 (+55.2%)
経常利益	1,700	6.5%	1,289	5.1%	+411 (+31.8%)
当期純利益	1,500	5.8%	1,038	4.1%	+462 (+44.4%)

※国内子会社2社の決算期変更に伴う売上高の増加6億円を含む

3. 中期経営計画進捗状況 および今後の運営方針

9

1. 事業ポートフォリオの見直し

- モールディング分野とシンギュレーション分野に経営資源を集中
- ボンダー事業を澁谷工業へ技術移転
- シンギュレーション事業部を新設

10

2. 販売戦略の強化

- IDMとの関係強化による取引拡大
顧客別担当制に営業組織を転換
- 基板の大型化対応製品の投入(YPS、YFT)
- LED封止装置FFTの本格的な拡販開始
LED機器営業部を新設
- シンギュレーション分野への新製品投入

11

3. QCDの最適化

- 国内金型工場の稼働率向上
モールド生産キャパアップ施策を実施
 - ・九州事業所の拡張工事完成
 - ・生産ラインの効率化
 - ・パーツ生産ラインの新設
- 海外装置生産工場の稼働率向上

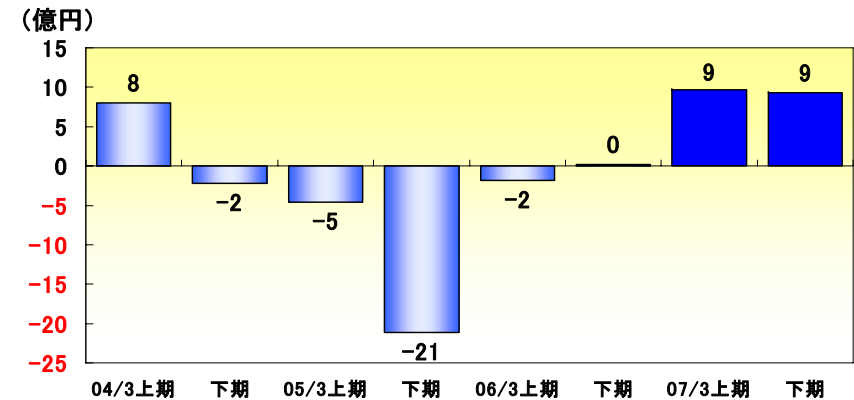
12

4. 財務体質の改善

- TOWA Singaporeの工場売却
日系メディカル企業への売却完了
- 連結借入金残高
06年3月169億円 → 07年3月139億円
- 営業キャッシュ・フローの改善
07年3月期 18億円の黒字

13

営業キャッシュフロー推移(連結)



14

5. 固定費の削減

- 従業員数
06年3月1,213名→07年3月1,108名
- ・TOWA Singaporeの閉鎖
06年3月従業員128名→APへ移籍36名
- ・TOWA-Interconの大幅リストラ
06年3月従業員63名→07年3月22名

15

6. 企業文化・企業組織の改革

- 全社体質改善運動を展開
- 業務改革・ERP委員会の立ち上げ
「CHANGEプロジェクト」をスタート
Challenge30 Has A New Generation Experience
業務プロセスの全面見直し

16

2008年3月期 最重点戦略

▶ シェアアップ(50%超)

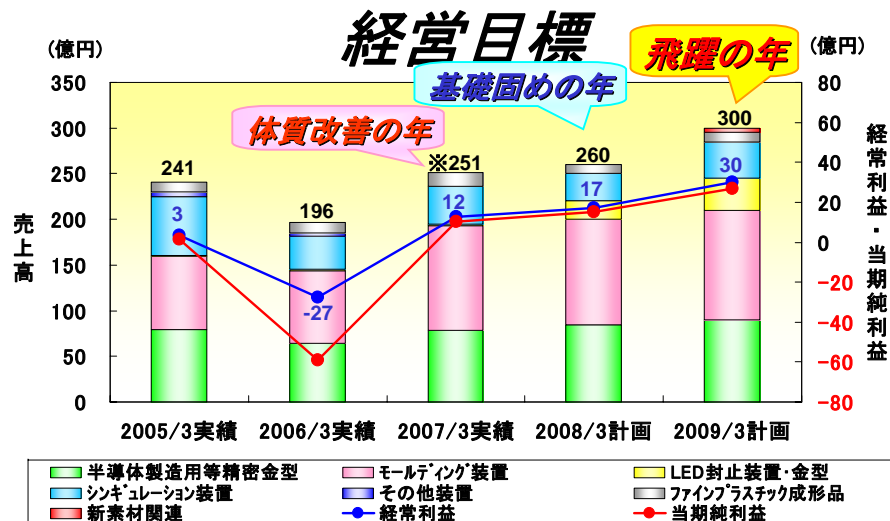
- 金型の生産キャパアップ
- 短納期

17

今後の長期的戦略

1. PM、新素材の市場投入
2. LED市場での拡販
3. シンギュレーション装置の
トップシェア奪還
4. 新市場でのコア・コンピタンスの展開

18



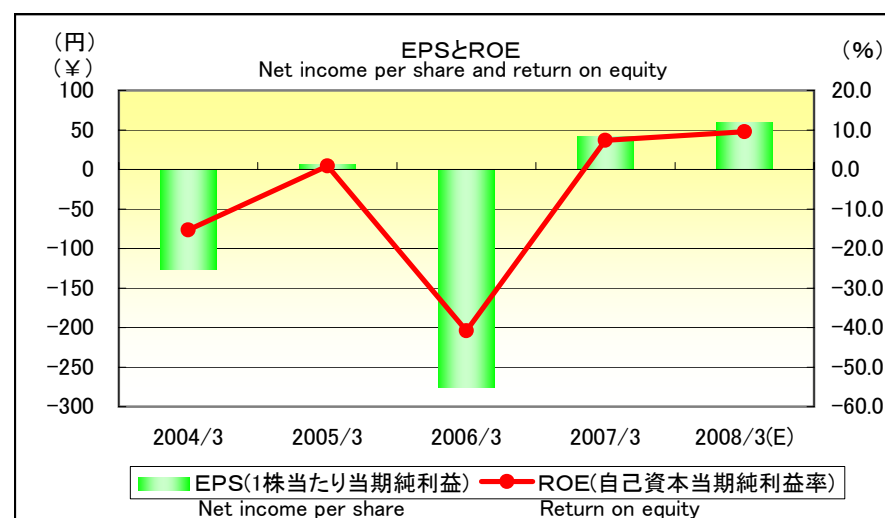
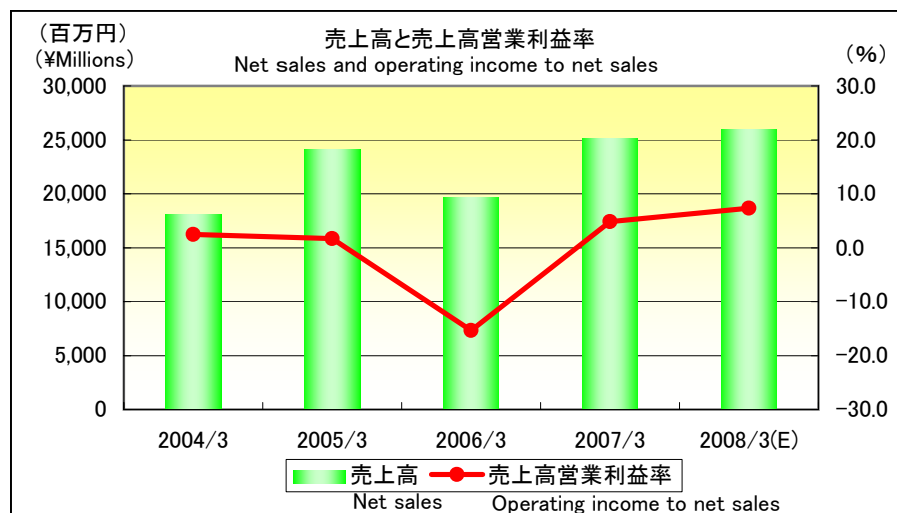
※国内子会社2社の決算期変更に伴う売上高の増加6億円を含む

19

質疑応答

20

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



決算期		2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions					
売上高	Net sales	18,101	24,111	19,641	25,159	26,000
営業利益	Operating income	449	402	-3,012	1,224	1,900
経常利益	Ordinary income	335	326	-2,778	1,289	1,700
当期純利益	Net income	-2,615	146	-5,923	1,038	1,500
総資産	Total assets	35,560	38,343	36,602	34,925	—
純資産	Net assets	15,703	15,998	13,003	14,941	—
1株当たり指標	Per share data					
1株当たり当期純利益	Net income per share	-126.00	7.04	-275.58	41.59	59.96
諸指標	Data					
自己資本当期純利益率	Return on equity	-15.3	0.9	-40.8	7.4	9.6
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	0.9	0.9	-7.4	3.6	—
売上高営業利益率	Operating income to net sales	2.5	1.7	-15.3	4.9	7.3
自己資本比率	Equity ratio	44.2	41.7	35.5	42.8	—

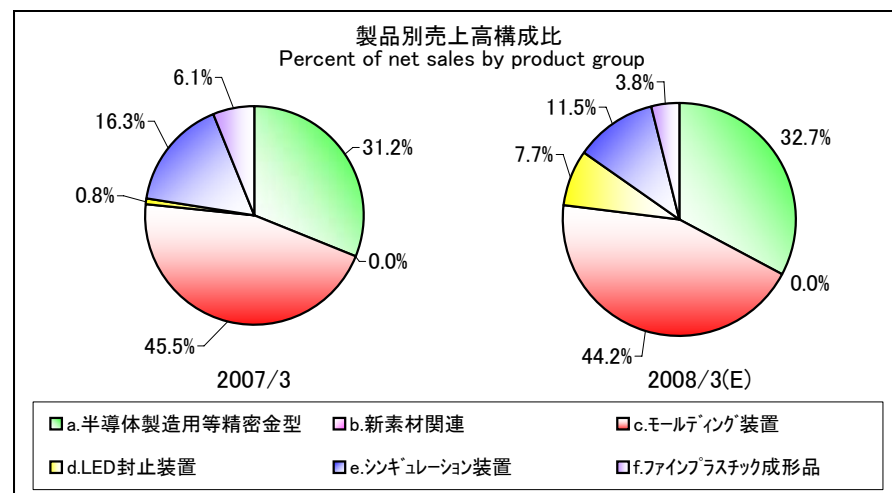
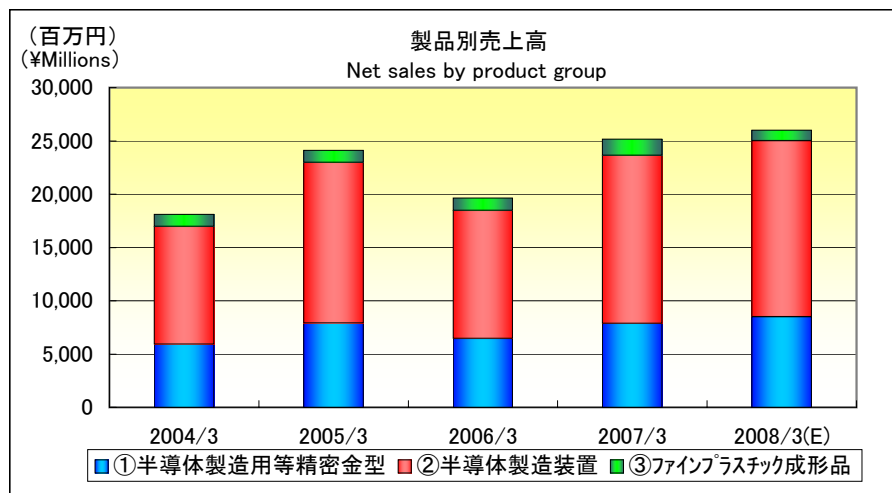
(単位: 百万円/¥Millions)

	2006/9	2007/9(E)
売上高	12,346	12,000
営業利益	559	700
経常利益	528	600
当期純利益	400	500
総資産	36,478	—
純資産	14,036	—
1株当たり当期純利益	16.05	19.98
自己資本当期純利益率	3.0	3.3
総資産経常利益率	1.4	—
売上高営業利益率	4.5	5.8
自己資本比率	38.5	—

増減率	Percent change	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
売上高	Net sales	25.3	33.2	-18.5	28.1	3.3
営業利益	Operating income	—	-10.5	—	—	55.2
経常利益	Ordinary income	—	-2.7	—	—	31.8
当期純利益	Net income	—	—	—	—	44.1

	2006/9	2007/9(E)
売上高	90.0	-2.8
営業利益	—	25.1
経常利益	—	13.5
当期純利益	—	25.0

II. 製品別売上高(連結) Net Sales by Product Group (Consolidated)



※ 従来半導体製造用等精密金型に分類していましたがシンギュレーション金型部品を半導体製造装置に含めて表示しております。

製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2004/3		2005/3		2006/3		2007/3		2008/3(E)	
売上高合計 Total sales	18,101	100.0	24,111	100.0	19,641	100.0	25,159	100.0	26,000	100.0
半導体製造用等精密金型(a,b)※	5,921	32.7	7,892	32.7	6,462	32.9	7,861	31.2	8,500	32.7
半導体製造装置(c,d,e,f)※	11,048	61.0	15,089	62.5	12,017	61.1	15,766	62.7	16,500	63.5
ファインプラスチック成形品(g)※	1,132	6.3	1,129	4.7	1,161	5.9	1,531	6.1	1,000	3.8

(単位: 百万円/¥Millions)

決算期	2006/9		2007/9(E)	
売上高合計 Total sales	12,346	100.0	12,000	100.0
半導体製造用等精密金型	3,746	30.3	4,200	35.0
半導体製造装置	8,031	65.0	7,300	60.8
ファインプラスチック成形品	568	4.6	500	4.2

増減率 Percent change

決算期	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
売上高合計 Total sales	25.3	33.2	-18.5	28.1	3.3
半導体製造用等精密金型	37.8	33.3	-18.1	21.6	8.1
半導体製造装置	25.4	36.6	-20.4	31.2	4.7
ファインプラスチック成形品	-15.3	-0.3	2.8	31.9	-34.7

決算期	2006/9	2007/9(E)
売上高合計 Total sales	90.0	-2.8
半導体製造用等精密金型	64.1	12.1
半導体製造装置	120.7	-9.1
ファインプラスチック成形品	-1.2	-12.0

※a.Precision molds

d.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED

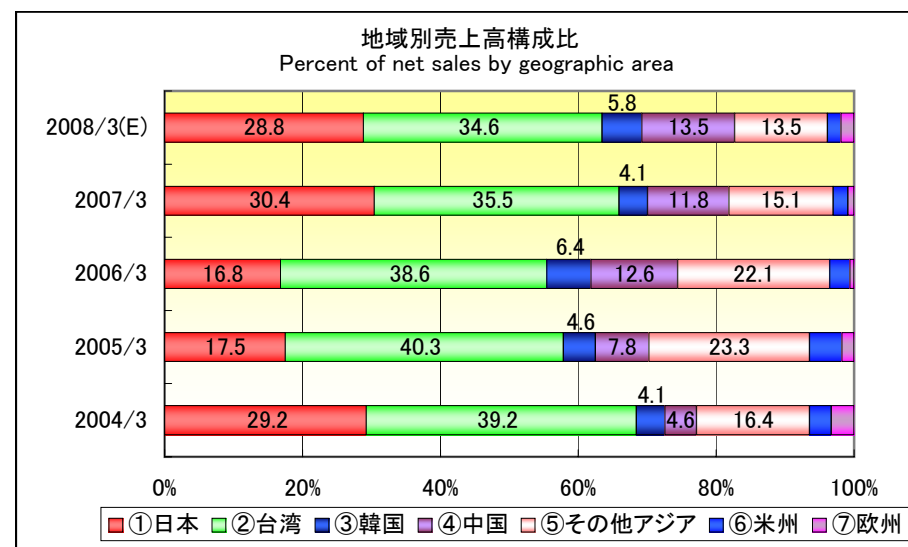
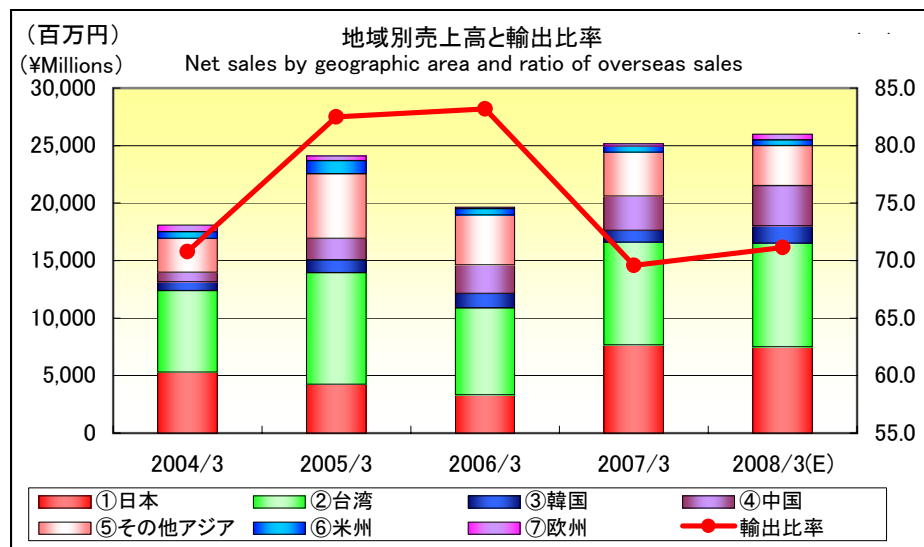
b.New material molds

e.Sigation parts and systems

c.Semiconductor plastic encapsulation systems

f.Engineering plastic molded products

地域別売上高(連結) Net Sales by Geographic Area (Consolidated)



地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期		2004/3		2005/3		2006/3		2007/3		2008/3(E)	
売上高合計	Total sales	18,101	100.0	24,111	100.0	19,641	100.0	25,159	100.0	26,000	100.0
日本	①Japan	5,290	29.2	4,220	17.5	3,302	16.8	7,653	30.4	7,500	28.8
輸出売上高	Overseas	12,811	70.8	19,891	82.5	16,338	83.2	17,506	69.6	18,500	71.2
アジア太平洋	Asia pacific	11,645	64.3	18,336	76.0	15,644	79.6	16,742	66.5	17,500	67.3
(内 台湾)	②Taiwan	7,091	39.2	9,728	40.3	7,582	38.6	8,927	35.5	9,000	34.6
(内 韓国)	③Korea	748	4.1	1,113	4.6	1,262	6.4	1,040	4.1	1,500	5.8
(内 中国)	④China	838	4.6	1,873	7.8	2,465	12.6	2,969	11.8	3,500	13.5
(内 その他アジア)	⑤Other asia	2,967	16.4	5,620	23.3	4,333	22.1	3,805	15.1	3,500	13.5
米州	⑥America	564	3.1	1,125	4.7	578	2.9	543	2.2	500	1.9
欧州	⑦Europe	600	3.3	428	1.8	115	0.6	220	0.9	500	1.9

(単位:百万円/¥Millions)

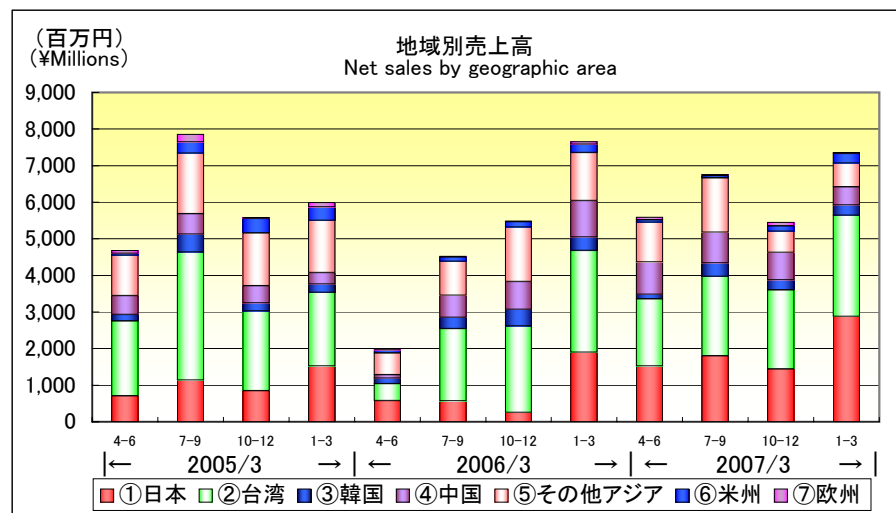
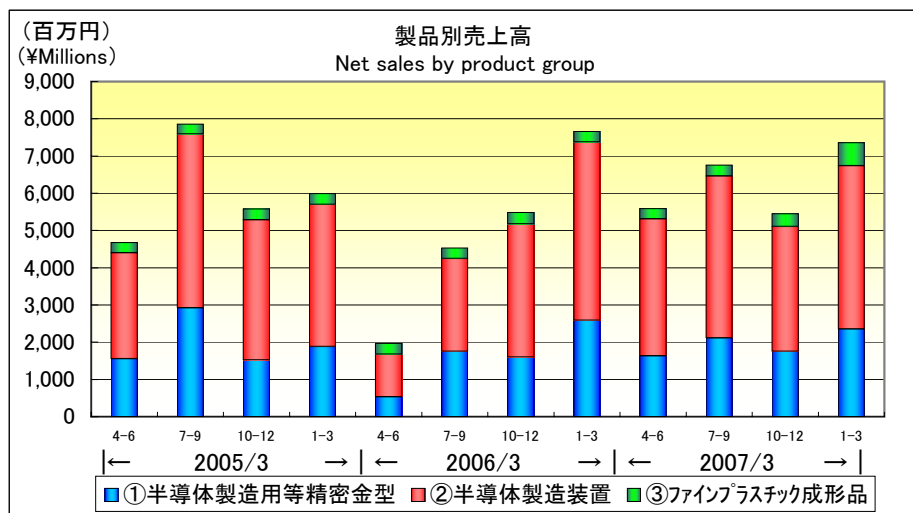
	2006/9		2007/9(E)	
	12,346	100.0	12,000	100.0
	3,325	26.9	3,000	25.0
	9,020	73.1	9,000	75.0
	8,787	71.2	8,500	70.8
	4,007	32.5	4,500	37.5
	484	3.9	700	5.8
	1,724	14.0	1,600	13.3
	2,571	20.8	1,700	14.2
	138	1.1	300	2.5
	95	0.8	200	1.7

増減率 Percent change

決算期		2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
売上高合計	Total sales	25.3	33.2	-18.5	28.1	3.3
日本	①Japan	39.9	-20.2	-21.8	131.8	-2.0
輸出売上高	Overseas	20.2	55.3	-17.9	7.1	5.7
アジア太平洋	Asia pacific	15.1	57.5	-14.7	7.0	4.5
(内 台湾)	②Taiwan	27.0	37.2	-22.1	17.7	0.8
(内 韓国)	③Korea	-36.2	48.8	13.4	-17.6	44.2
(内 中国)	④China	-18.3	123.5	31.6	20.4	17.9
(内 その他アジア)	⑤Other asia	27.2	89.4	-22.9	-12.2	-8.0
米州	⑥America	32.1	99.5	-48.6	-6.1	-7.9
欧州	⑦Europe	417.2	-28.7	-73.1	91.3	127.3

	2006/9	2007/9(E)
	90.0	-2.8
	188.9	-9.8
	68.7	-0.2
	71.8	-3.3
	64.2	12.3
	9.0	44.6
	145.9	-7.2
	68.0	-33.9
	-29.9	117.4
	196.9	110.5

四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



※ 従来半導体製造用等精密金型に分類していましたが、シンギュレーション金型部品を半導体製造装置に含めて表示しております。

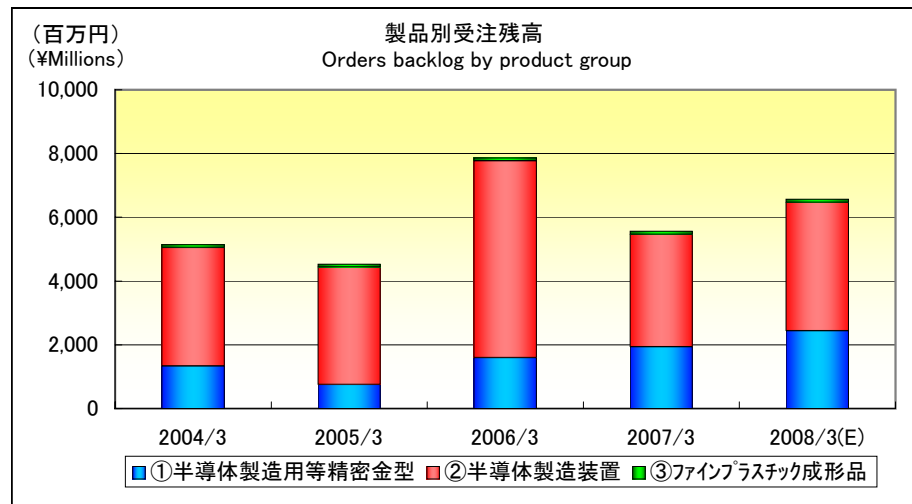
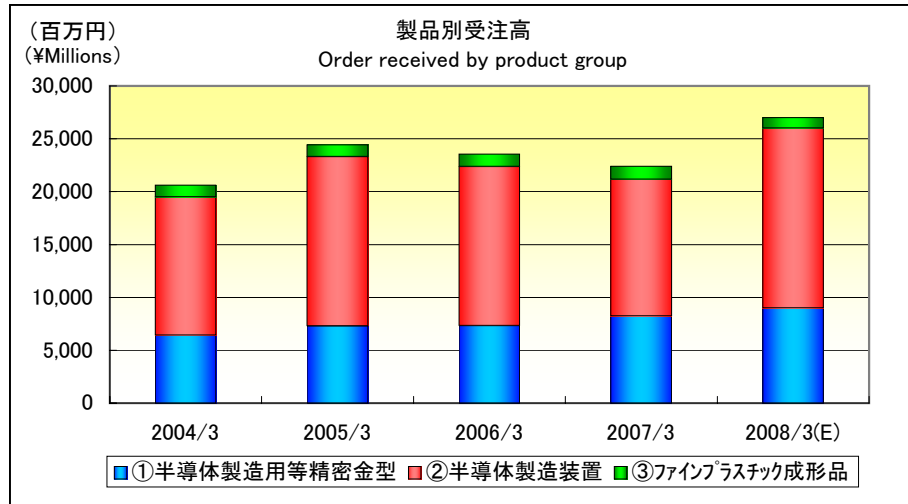
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2005/3					2006/3					2007/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	4,678	7,859	5,578	5,994	24,111	1,970	4,528	5,483	7,659	19,641	5,589	6,756	5,451	7,362	25,159
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	1,559	2,924	1,523	1,885	7,891	531	1,751	1,598	2,588	6,462	1,633	2,112	1,755	2,359	7,861
半導体製造装置 ② Semiconductor manufacturing equipment	2,845	4,667	3,761	3,815	15,088	1,144	2,494	3,581	4,788	12,017	3,680	4,351	3,355	4,379	15,766
ファインプラスチック成形品 ③ Engineering plastic molded products	274	268	293	293	1,129	294	281	302	282	1,161	275	293	341	622	1,531
月平均	1,559	2,620	1,859	1,998	2,009	657	1,509	1,828	2,553	1,637	1,863	2,252	1,817	2,454	2,097

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2005/3					2006/3					2007/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	4,678	7,859	5,578	5,994	24,111	1,970	4,528	5,483	7,659	19,641	5,589	6,756	5,451	7,362	25,159
日本 ① Japan	711	1,139	845	1,524	4,220	581	571	254	1,896	3,302	1,519	1,805	1,447	2,880	7,653
アジア太平洋 Asia pacific	3,839	6,199	4,315	3,983	18,336	1,302	3,814	5,069	5,458	15,644	3,927	4,858	3,762	4,192	16,742
(内 台湾) ② Taiwan	2,040	3,498	2,177	2,012	9,728	463	1,976	2,362	2,779	7,582	1,842	2,165	2,157	2,761	8,927
(内 韓国) ③ Korea	181	485	224	222	1,113	143	300	450	368	1,262	117	366	272	283	1,040
(内 中国) ④ China	514	567	470	321	1,873	97	604	762	1,001	2,465	884	840	751	493	2,969
(内 その他アジア) ⑤ Other asia	1,102	1,647	1,443	1,426	5,620	597	933	1,494	1,309	4,333	1,084	1,486	580	654	3,805
米州 ⑥ America	52	312	394	366	1,125	76	120	147	233	578	74	64	146	258	543
欧州 ⑦ Europe	75	208	23	120	428	9	22	12	70	115	66	28	94	31	220

Ⅲ. 製品別受注高(連結) Orders Received by Product Group (Consolidated)



※ 従来半導体製造用等精密金型に分類していましたがシンギュレーション金型部品を半導体製造装置に含めて表示しております。

製品別受注高 Order received by product group

決算期	2004/3		2005/3		2006/3		2007/3		2008/3(E)	
受注高合計 Total order received	20,629	100.0	24,435	100.0	23,547	100.0	22,388	100.0	27,000	100.0
半導体製造用等精密金型	6,416	31.1	7,282	29.8	7,318	31.1	8,232	36.8	9,000	33.3
① Precision molds										
半導体製造装置	13,087	63.4	16,018	65.6	15,068	64.0	12,915	57.7	17,000	63.0
② Semiconductor manufacturing equipment										
ファインプラスチック成形品	1,126	5.5	1,134	4.6	1,161	4.9	1,241	5.5	1,000	3.7
③ Engineering plastic molded products										

製品別受注残高 Order backlog by product group

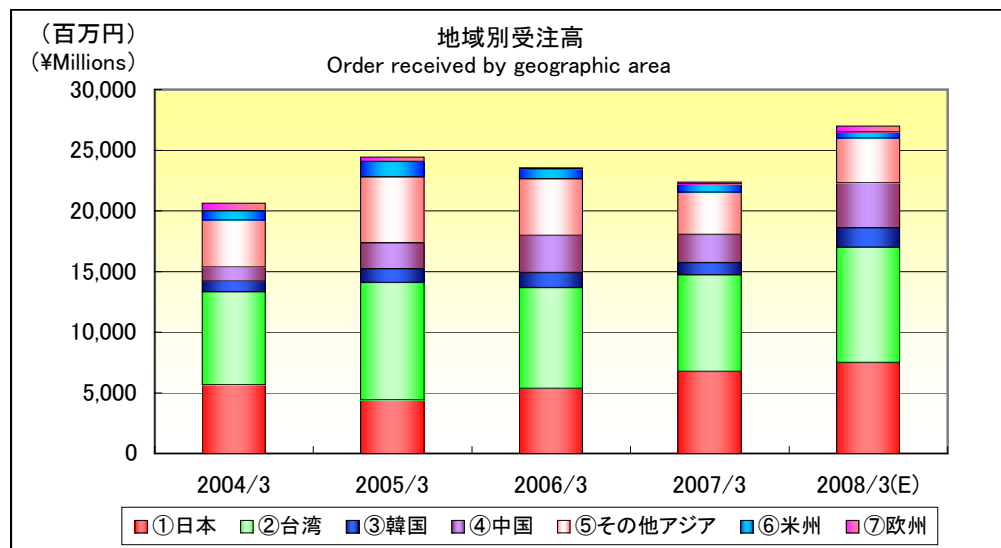
決算期	2004/3		2005/3		2006/3		2007/3		2008/3(E)	
受注残高合計 Total order backlog	5,138	100.0	4,533	100.0	7,859	100.0	5,565	100.0	6,565	100.0
半導体製造用等精密金型	1,339	26.1	753	16.6	1,595	20.3	1,938	34.8	2,438	37.1
① Precision molds										
半導体製造装置	3,713	72.3	3,688	81.3	6,172	78.5	3,526	63.4	4,026	61.3
② Semiconductor manufacturing equipment										
ファインプラスチック成形品	85	1.7	90	2.0	91	1.2	100	1.8	100	1.5
③ Engineering plastic molded products										

(単位: 百万円/¥Millions)

決算期	2006/9		2007/9(E)	
受注高合計 Total order received	12,479	100.0	12,000	100.0
半導体製造用等精密金型	4,286	34.3	4,200	35.0
① Precision molds				
半導体製造装置	7,614	61.0	7,300	60.8
② Semiconductor manufacturing equipment				
ファインプラスチック成形品	578	4.6	500	4.2
③ Engineering plastic molded products				

決算期	2006/9		2007/9(E)	
受注残高合計 Total order backlog	7,490	100.0	5,565	100.0
半導体製造用等精密金型	2,135	28.5	1,938	34.8
① Precision molds				
半導体製造装置	5,253	70.1	3,526	63.4
② Semiconductor manufacturing equipment				
ファインプラスチック成形品	100	1.3	100	1.8
③ Engineering plastic molded products				

地域別受注高(連結) Order Received by Geographic Area (Consolidated)



地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2004/3		2005/3		2006/3		2007/3		2008/3(E)	
受注高合計 Total order received	20,629	100.0	24,435	100.0	23,547	100.0	22,388	100.0	27,000	100.0
日本 ①Japan	5,649	27.4	4,418	18.1	5,361	22.8	6,742	30.1	7,500	27.8
アジア太平洋 Asia pacific	13,589	65.9	18,378	75.2	17,277	73.4	14,788	66.1	18,500	68.5
(内 台湾) ②Taiwan	7,679	37.2	9,659	39.5	8,314	35.3	7,994	35.7	9,500	35.2
(内 韓国) ③Korea	878	4.3	1,143	4.7	1,227	5.2	1,002	4.5	1,600	5.9
(内 中国) ④China	1,154	5.6	2,142	8.8	3,072	13.0	2,316	10.3	3,700	13.7
(内 その他アジア) ⑤Other asia	3,877	18.8	5,433	22.2	4,663	19.8	3,475	15.5	3,700	13.7
米州 ⑥America	757	3.7	1,266	5.2	799	3.4	677	3.0	500	1.9
欧州 ⑦Europe	633	3.1	372	1.5	109	0.5	179	0.8	500	1.9

(単位: 百万円/¥Millions)

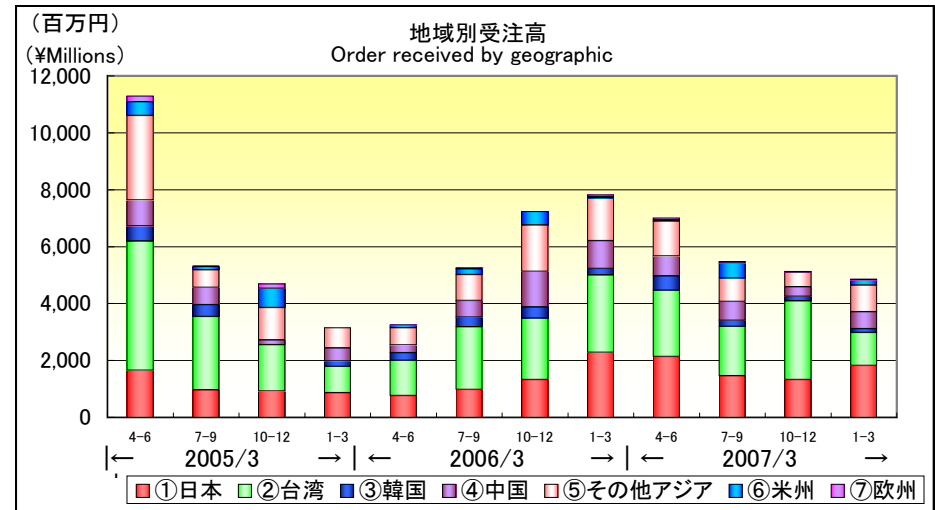
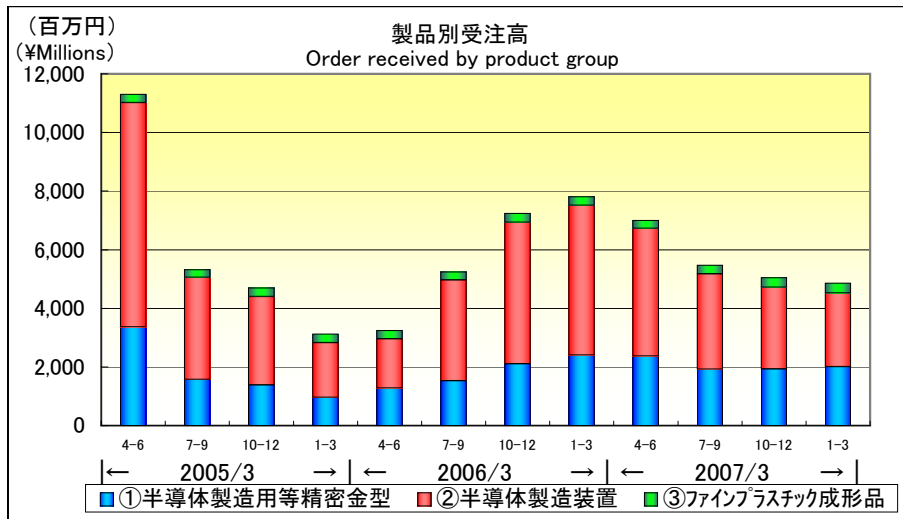
2006/9		2007/9(E)	
12,479	100.0	12,000	100.0
3,599	28.8	3,000	25.0
8,191	65.6	8,500	70.8
4,061	32.5	4,500	37.5
712	5.7	700	5.8
1,369	11.0	1,600	13.3
2,047	16.4	1,700	14.2
578	4.6	300	2.5
111	0.9	200	1.7

増減率 Percent change

決算期	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
受注高合計 Total order received	37.4	18.4	-3.6	-4.9	20.6
日本 ①Japan	32.0	-21.8	21.3	25.8	11.2
アジア太平洋 Asia pacific	33.5	35.2	-6.0	-14.4	25.1
(内 台湾) ②Taiwan	39.2	25.8	-13.9	-3.8	18.8
(内 韓国) ③Korea	-31.4	30.2	7.3	-18.3	59.7
(内 中国) ④China	14.0	85.6	43.4	-24.6	59.8
(内 その他アジア) ⑤Other asia	63.5	40.1	-14.2	-25.5	6.5
米州 ⑥America	53.5	67.2	-36.9	-15.3	-26.1
欧州 ⑦Europe	1,010.5	-41.2	-70.7	64.2	179.3

2006/9	2007/9(E)
46.9	-3.8
106.2	-16.6
27.7	3.8
18.0	10.8
17.1	-1.7
62.0	16.9
34.6	-17.0
95.9	-48.1
192.1	80.2

四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



※ 従来半導体製造用等精密金型に分類していましたがシンギュレーション金型部品を半導体製造装置に含めて表示しております。

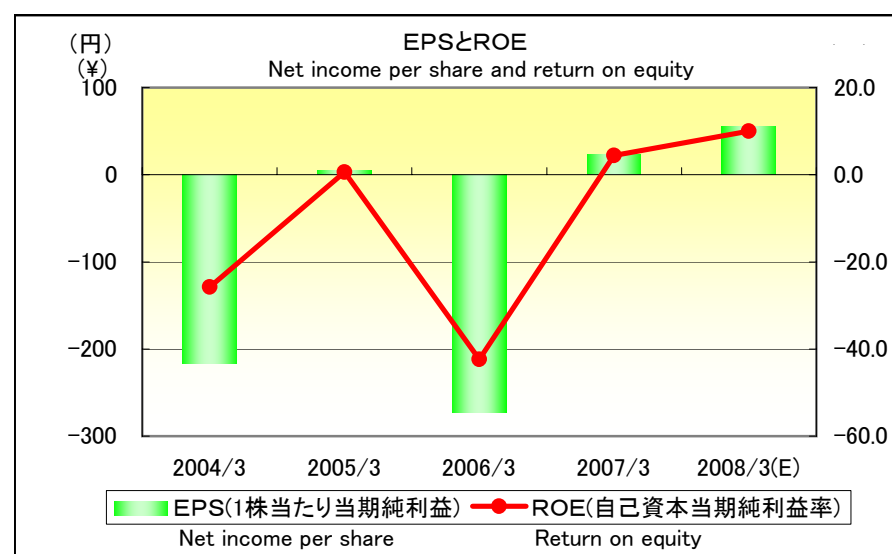
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2005/3					2006/3					2007/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	11,299	5,318	4,696	3,121	24,435	3,249	5,247	7,237	7,814	23,547	7,004	5,475	5,051	4,857	22,388
半導体製造用等精密金型															
① Precision molds	3,367	1,570	1,384	960	7,282	1,273	1,527	2,110	2,406	7,318	2,369	1,917	1,938	2,006	8,232
半導体製造装置															
② Semiconductor manufacturing equipment	7,653	3,485	3,016	1,863	16,018	1,685	3,442	4,828	5,110	15,068	4,359	3,254	2,783	2,516	12,915
ファインプラスチック成形品															
③ Engineering plastic molded products	278	263	295	297	1,134	290	276	297	295	1,161	275	302	328	333	1,241
月平均	3,766	1,773	1,565	1,040	2,036	1,083	1,749	2,412	2,605	1,962	2,335	1,825	1,684	1,619	1,866

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2005/3					2006/3					2007/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	11,299	5,318	4,696	3,121	24,435	3,249	5,247	7,237	7,814	23,547	7,004	5,475	5,051	4,857	22,388
日本 ① Japan	1,650	969	927	871	4,418	763	982	1,331	2,283	5,361	2,133	1,465	1,322	1,821	6,742
アジア太平洋 Asia pacific	8,958	4,215	2,928	417	18,378	2,384	4,032	5,433	5,427	17,277	4,760	3,432	3,770	2,826	14,788
(内 台湾) ② Taiwan	4,545	2,570	1,630	913	9,659	1,242	2,199	2,155	2,717	8,314	2,337	1,724	2,767	1,164	7,994
(内 韓国) ③ Korea	529	421	192	1,143	2,677	341	389	229	1,227	1,498	214	158	131	1,002	
(内 中国) ④ China	908	609	160	463	2,142	267	578	1,251	975	3,072	698	671	345	600	2,316
(内 その他アジア) ⑤ Other asia	2,974	613	1,138	707	5,433	606	915	1,636	1,505	4,663	1,226	821	498	929	3,475
米州 ⑥ America	482	120	680	-16	1,266	92	203	464	38	799	49	528	-78	177	677
欧州 ⑦ Europe	208	13	160	-10	372	8	30	7	64	109	60	50	36	32	179

IV. 決算概況(個別) Operating Results (Non-Consolidated)



決算期		2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions					
売上高	Net sales	13,703	17,237	16,277	20,444	25,000
営業利益	Operating income	54	-74	-1,456	1,644	1,700
経常利益	Ordinary income	61	29	-1,363	1,689	1,500
当期純利益	Net income	-4,493	89	-5,846	573	1,400
総資産	Total assets	30,618	33,472	31,982	32,308	—
純資産	Net assets	15,296	15,548	12,017	13,250	—
1株当たり指標	Per share data					
1株当たり当期純利益	Net income per share	-216.46	4.32	-272.04	22.98	55.97
1株当たり配当金	Dividends per share	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
諸指標	Data					
自己資本当期純利益率	Return on equity	-25.8	0.6	-42.4	4.5	10.0
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	0.2	0.1	-4.2	5.3	—
売上高営業利益率	Operating income to net sales	0.4	-0.4	-8.9	8.0	6.8
自己資本比率	Equity ratio	50.0	46.5	37.6	41.0	—

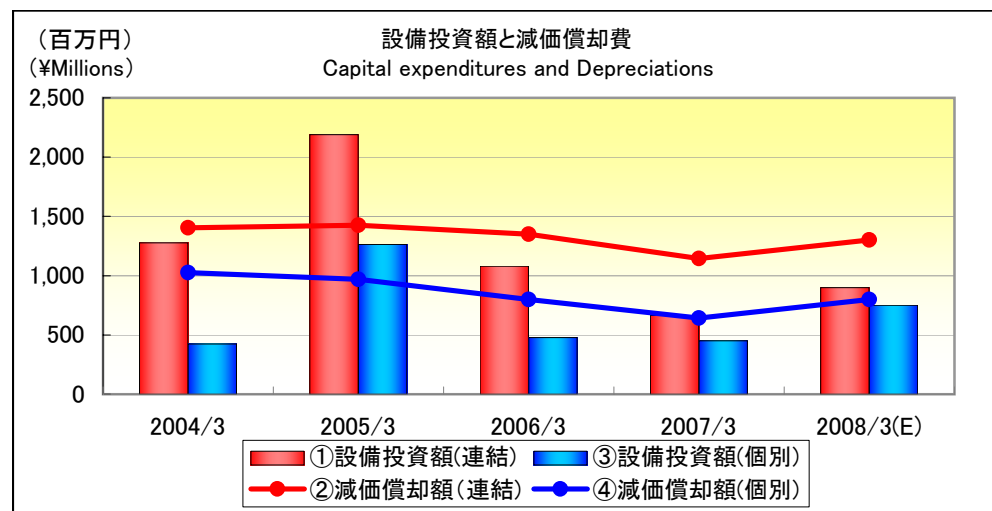
(単位: 百万円/¥Millions)

	2006/9	2007/9(E)
売上高	10,185	11,500
営業利益	994	600
経常利益	1,059	500
当期純利益	352	450
総資産	32,563	—
純資産	13,070	—
1株当たり当期純利益	14.13	17.99
1株当たり配当金	0.00	0.00
自己資本当期純利益率	2.8	3.3
総資産経常利益率	3.3	—
売上高営業利益率	9.8	5.2
自己資本比率	40.1	—

増減率	Percent change	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
決算期						
売上高	Net sales	32.3	25.8	-5.6	25.6	22.3
営業利益	Operating income	—	—	—	—	3.4
経常利益	Ordinary income	—	-53.0	—	—	-11.2
当期純利益	Net income	—	—	—	—	143.9

	2006/9	2007/9(E)
売上高	100.2	12.9
営業利益	—	-39.7
経常利益	—	-52.8
当期純利益	—	27.8

V. キャッシュフロー、設備投資額 Cash Flows and Capital Expenditures



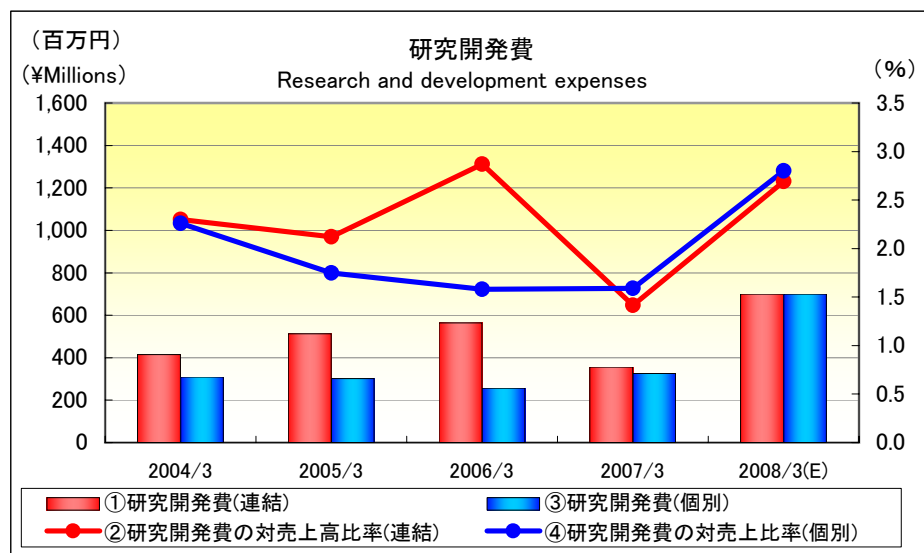
(連結) (Consolidated)		2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
決算期						
キャッシュフロー	Cash flows					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	581	-2,571	-166	1,894	—
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-1,319	-1,883	-1,548	252	—
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-179	3,947	2,232	-2,203	—
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalentsat	3,479	2,959	3,588	3,542	—
設備投資額	①Capital expenditures	1,276	2,189	1,079	663	900
減価償却費	②Depreciations	1,403	1,425	1,349	1,144	1,300

(単位: 百万円/¥Millions)		
	2006/9	2007/9(E)
営業活動によるキャッシュフロー	963	—
投資活動によるキャッシュフロー	-256	—
財務活動によるキャッシュフロー	-455	—
現金および現金同等物期末残高	3,813	—
設備投資額	388	400
減価償却費	608	600

(個別) (Non-Consolidated)		2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
決算期						
設備投資額	③Capital expenditures	425	1,264	478	452	750
減価償却費	④Depreciations	1,025	968	798	643	800

(単位: 百万円/¥Millions)		
	2006/9	2007/9(E)
設備投資額	285	300
減価償却費	323	350

VI. 研究開発費 Research and Development Expenses



(連結) (Consolidated)

決算期	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
研究開発費	415	512	564	356	700
①Research and development expenses					
研究開発費の対売上比率	2.30	2.12	2.87	1.42	2.69
②Ratio of sales to research and development expenses					

増減率 Percent change

決算期	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
研究開発費	-57.7	23.4	10.2	-36.9	96.6
Research and development expenses					

(個別) (Non-Consolidated)

決算期	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
研究開発費	309	301	257	325	700
③Research and development expenses					
研究開発費の対売上比率	2.26	1.75	1.58	1.59	2.80
④Ratio of sales to research and development expenses					

増減率 Percent change

決算期	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3(E)
研究開発費	-54.6	-2.6	-14.6	26.5	115.4
Research and development expenses					

(単位: 百万円/¥Millions)

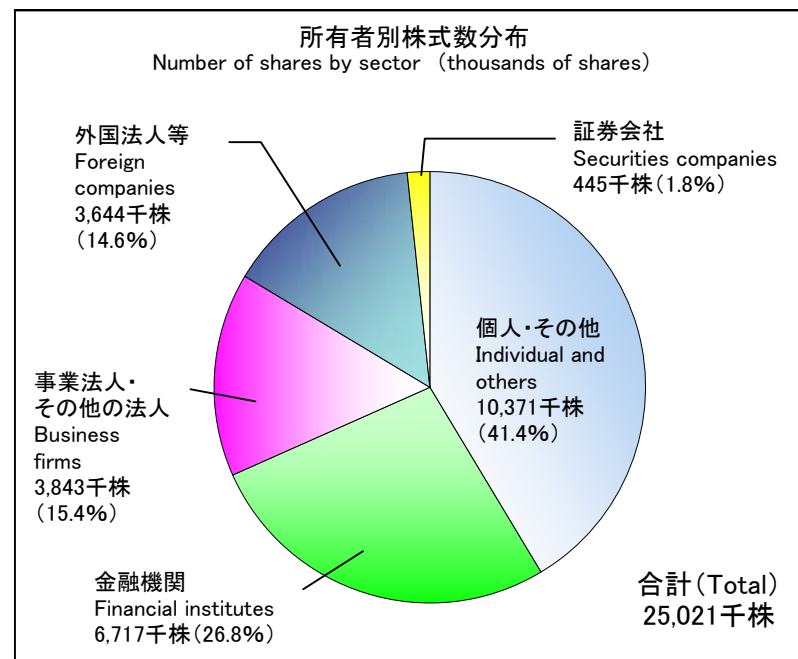
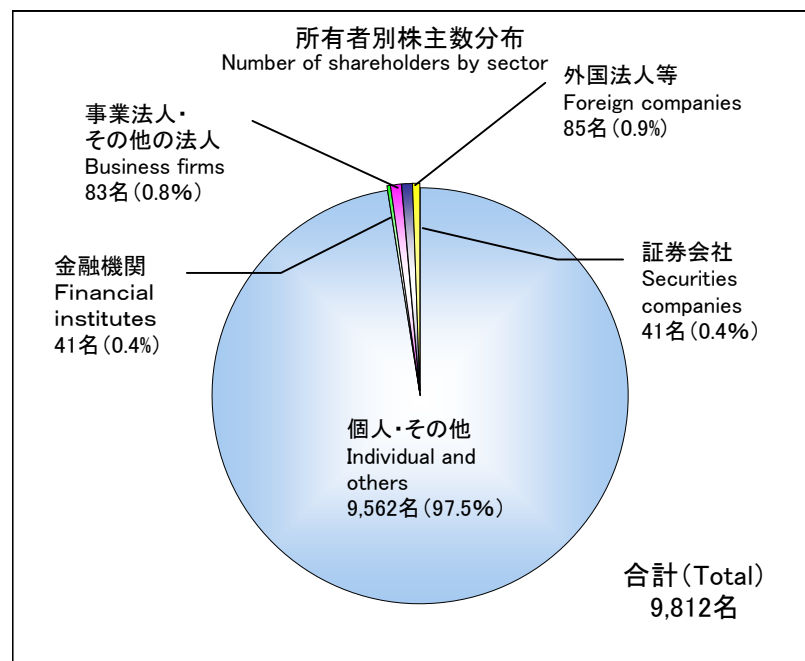
	2006/9	2007/9(E)
研究開発費	199	350
研究開発費の対売上比率	1.61	2.92

	2006/9	2007/9(E)
増減率	24.4	75.9

	2006/9	2007/9(E)
研究開発費	178	350
研究開発費の対売上比率	1.75	3.04

	2006/9	2007/9(E)
増減率	63.3	96.6

VII. 株式の状況 (2007年3月31日現在) State of Shares (March 31, 2007)



■大株主

Major Shareholders

株主名	Major Shareholders	当社への出資状況	
		Investment to the Company	
		所有株式数(千株) Thousands of shares	持株比率 Proportion
坂東和彦	Kazuhiko Bandoh	2,094	8.37%
(有)ケイビー恒産	K.B.Kosan Ltd.	2,000	7.99%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	Japan Trustee Services Bank, Ltd.	1,830	7.32%
資産管理サービス信託銀行(株)	Trust & Custody Services Bank, Ltd.	1,445	5.78%
(株)京都銀行	The Bank of Kyoto, Ltd.	699	2.80%
モルガンスタンレー アンド カンパニー インターナショナル リミテッド*	Morgan Stanley & Co. International Limited	688	2.75%
日興シティ信託銀行(株)	NikkoCiti Trust and Banking Corporation.	664	2.66%
日本マスタートラスト信託銀行(株)	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	659	2.64%
ビーエスビー パリバセキリティーズ サービス ルクセンブルグ ジャスデック セキリティーズ*	BNP Paribas Securities Services Luxembourg Jasdec Securities.	540	2.16%
山田矩規子	Kumiko Yamada	501	2.00%